

7748 **ホロン**

穴澤 紀道 (アナザワ ノリミチ)

株式会社ホロン社長

## NEDO の事業採択を受けて新商品開発を推進

### ◆2010年3月期第2四半期決算の概要

当上期の業績については、2009年11月9日付で利益についての修正を公表している。売上高は、当社の主力商品であるフォトマスク用寸法測定装置「EMU」の販売が順調に推移し、当初予想に対して5%増の5億85百万円となった。

一方で利益については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づき見直しを行った結果、当第2四半期においてたな卸資産評価損28百万円を売上原価に計上した。

そのため、営業利益5百万円、経常利益8百万円、四半期純利益6百万円と当初予想を下回る結果となったものの、黒字化を果たした。

昨年来の金融危機をきっかけとした世界同時不況の余波は大きく、半導体業界においても設備需要は依然として低迷しているが、当社製品は開発投資に積極的な大手企業の性能評価を得て販売実績を伸ばしており、前年同期比461.8%増の大幅増収となった。

売上総利益2億52百万円に対し、販管費は前年同期より43百万円増加して2億47百万円(前年同期比21.3%増)となった。これは組織変更による人件費の移動と、製品販売にかかわる手数料等の発生によるものである。

当上期末の現預金は前期末より1億48百万円減少した。売掛債権は2億81百万円増加した一方で、たな卸資産は1億79百万円減少した結果、流動資産は前期末より8.7%減少した。

無形固定資産の6百万円増などにより、固定資産は前期末より7.7%増加した。この結果、総資産は前期末より6.4%減少し、8億28百万円となった。

負債については、仕入債務(買掛金)の67百万円減少などにより、流動負債は前期末より16.3%減少した。固定負債は、長期借入金の8百万円減少などにより、前期末より5.3%減少した。この結果、負債合計は前期末より14.3%減少し、3億80百万円となった。

純資産については、利益剰余金が6百万円増加したことにより、前期末より1.5%増加して4億47百万円となった。

当上期末の現金および現金同等物残高は、前年同期末より2億5百万円減少して59百万円となった。営業キャッシュフローは1億32百万円減少しているが、これはたな卸資産の減少1億86百万円、売上債権の増加2億81百万円、仕入債務の減少69百万円などによる。

投資キャッシュフローは9百万円減少したが、これは固定資産の取得があったことによる。財務キャッシュフローは8百万円減少したが、これは長期借入金の返済が8百万円あったことによる。

当上期の販管費増加は主に人件費と販売手数料の増加によるが、人件費の増加は5月に行った組織の再編成によるものである。

この組織変更は営業活動の強化を目的としており、小さい会社ならではのフットワークの軽さを活かし、情報共有と意思疎通の迅速化を図ってきた。さらに、顧客ニーズを的確に把握して即時対応できる体制を構築するため

に、営業統括下に応用技術部を発足させた。営業活動に同行していた技術員数名を選抜し、技術部門から5名を販売・管理部門にシフトしたことにより、人件費は19百万円増加した。

また、販売手数料においては、代理店を通して中国企業に販売した結果、販売手数料が22百万円増加した。

### ◆通期の業績見通し

景気の先行きは依然として不透明ではあるが、当上期はほぼ計画どおりに進捗したことから、通期の業績については5月12日付で公表した当初予想は変更しない。

通期では売上高10億10百万円、営業利益38百万円、経常利益35百万円、当期純利益27百万円と見込んでいる。

今期は第2四半期に入って回復が見られる産業が多いものの、当社の半導体マスク市場においては、前期後半からの設備投資需要を受けて当第1四半期は受注が好調に推移し、4億45百万円の受注実績となった。

これは営業強化のための組織編成の効果もあり、顧客ニーズに迅速に対応することができた結果と認識している。

一方で、当第2四半期(7-9月)には受注実績が62百万円となり、当上期の受注合計は5億7百万円となった。9月末の受注残は3億5百万円となっており、下期の受注上積みにより当期の売上高目標は達成できるものと考えている。

なお、当上期末のたな卸資産3億19百万円のうち、仕掛品は3億3百万円であるが、既に3億7百万円の評価減を行っている。特に今後受注するものが対象となっていることから、下期中の販売の実現を目指す。

### ◆下期の重点施策

今期は第2四半期に入って一般市場では設備投資に回復の兆しが見え始めており、半導体市場においても一部のメーカーは回復基調に入っている。

特に韓国、台湾では設備投資案件が動きだしていることから、上期の受注優先施策を継続し、確実にフォトマスク用寸法測定装置の受注に結びつけていきたい。

もう一つの主力製品である電子スタンプは高輝度LED生産における有用性が実証されており、LED市場の拡大に合わせて当社の受注も着実に拡大していく見込みである。

また、製品ラインアップの充実にも引き続き注力する。当社の技術コアである電子ビーム応用装置を開発し、機種を増やす取り組みを上期より進めている。

8月には、NEDOのイノベーション推進事業に「シームレスモールドステッパー製作とその実デバイス量産性能評価」、「電子ビーム式次世代パターン高速検査装置の開発」の2件が採択されている。

シームレスモールドステッパーは反射防止フィルムや偏光フィルターなどの用途を想定している。電子ビーム式次世代パターン高速検査装置は、従来の光学式では検査できない超微細なパターンを検査することを目的としており、今後の市場拡大が期待できる分野である。

当社は現在、売上高の9割をフォトマスク用寸法装置に依存しており、この比率を来期中に55%まで引き下げるべく、電子スタンプその他の拡販に努めている。

2011年に向けては、新たなシームレスモールドステッパーや検査装置を市場投入し、業界環境の変化に対応できるような製品ラインアップの充実を図りたい。また、当社の持っているコア技術のOEM供給を推進し、新たな事業の柱に育てる考えである。

## ◆質 疑 応 答◆

**足元の受注状況はどうか。**

当社に対する受注は、半導体が量産に入る前の設備投資の段階で出てくることから、半導体の生産量が増加する3カ月から半年前に受注が増加する関係になっている。

半導体各社の次の設備投資需要は、韓国・台湾を中心に年末から第4四半期にかけて出てくると予想している。

**通期の利益の見込みはどうなっているか。**

当社の製品は機種によって利益の変動幅が大きいことから、利益の見通しが立てにくくなっている。

(平成21年11月25日・東京)